证券代码：301285　　证券简称：鸿日达　　公告编号：2026-079

鸿日达科技股份有限公司

关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及拟注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鸿日达”）首次公开发行股票募集资金投资项目“半导体金属散热片材料项目”已完成募集资金承诺投资，该项目募集资金已基本使用完毕，且已达到预定可使用状态，公司决定将上述募投项目结项。待支付款项1,861.56万元将继续存放于原募集资金专项账户，专项用于已签订合同的款项支付，节余募集资金26.20万元永久补充流动资金，并拟注销上述募投项目募集资金专用账户。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，该事项可以免于履行董事会审议程序和保荐机构发表明确同意意见。现将相关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1447号《关于同意鸿日达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复同意，公司于2022年9月向社会公开发行人民币普通股（A股）5,167万股，每股发行价为14.60元，应募集资金总额为人民币75,438.20万元，根据有关规定扣除发行费用7,855.35万元后，实际募集资金金额为67,582.85万元。该募集资金已于2022年9月23日到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]215Z0050号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金投资项目计划情况

截至2026年9月30日，公司募集资金拟投资项目具体情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
承诺投资项目		
昆山汉江精密连接器生产项目	18,479.24	18,479.24
补充流动资金	6,000.00	6,000.00
半导体金属散热片材料项目	11,428.17	11,428.17
汽车高频信号线缆及连接器项目	3,411.20	3,411.20
光通信设备项目	7,864.24	7,864.24
半导体封装高端引线框架项目	1,070.24	1,070.24
承诺投资项目小计	48,253.09	48,253.09
超募资金投向		
归还银行贷款	-	5,700.00
永久补充流动资金	-	5,700.00
半导体封装高端引线框架项目	-	7,929.76
超募资金投向小计	-	19,329.76
合计	48,253.09	67,582.85

注 1：“半导体封装高端引线框架项目”总投资共计为 11,740.48 万元，具体由募集资金 9,000 万元（含超募资金 7,929.76 万元）、鸿科半导体自有资金 2,740.48 万元构成。

注 2：公司分别于 2023 年 8 月 18 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议，于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点、实施主体及募集资金专户和变更实施方式的议案》，同意在不改变募投项目的投资方向、投资总额、实施内容的情况下，将原 IPO 募投项目“昆山汉江精密连接器生产项目”中“软硬件设备购置及安装费用、铺底流动资金合计 23,687.01 万元的募集资金”的内容变更由全资子公司东台润田精密科技有限公司（以下简称“东台润田”）利用其现有厂房实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目新增实施地点、实施主体及募集资金专户和变更实施方式的公告》（公告编号：2023-054）。

注 3：公司分别于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目、使用超募资金、自有资金增加投资额并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司将原 IPO 募投项目“昆山汉江精密连接器生产项目”中剩余“建筑工程费用、工程建设其他费用和预备费用合计 18,566.08 万元的募集资金”的内容全部变更为由“半导体金属散热片材料项目”和“汽车高频信号线缆及连接器项目”使用。两个新项目合计总投资为 27,194 万元，拟使用原募投项目中建筑工程费用、工程建设其他费用和预备费用合计 18,566.08 万元的募集资金，同时使用超募资金 7,929.76 万元、自有资金 698.16 万元增加投资额。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目、使用超募资金、自有资金增加投资额并向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-027）。

注 4：公司分别于 2025 年 12 月 5 日召开第二届董事会第十九次会议，于 2025 年 12 月 22 日召开

2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司变更原募投项目中“昆山汉江精密连接器生产项目”和“汽车高频信号线缆及连接器项目”的部分募集资金用途，用于开展“光通信设备项目”和“半导体封装高端引线框架项目”（以下简称“半导体引线框架项目”），以进一步推进公司在光通信领域、半导体封装高端引线框架领域的布局，提高募集资金的使用效率与投资回报。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2025-082）。

二、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

（一）募投项目结项及募集资金节余情况

截至本公告披露日，本次结项募投项目累计投入募集资金及节余募集资金具体情况如下：

单位：万元

名称	募集资金拟投入金额①	已支付募集资金情况②	待支付合同款项③	利息及现金管理等收益且扣除手续费净额④	节余募集资金⑤=①-②-③+④
半导体金属散热片材料项目	11,428.17	9,562.02	1,861.56	21.61	26.20

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。

（二）本次募投项目节余募集资金的使用计划

截至本公告披露日，半导体金属散热片材料项目已达到预定可使用状态，计划投入募集资金金额已按规定基本使用完毕。

为合理使用募集资金，增强公司持续经营能力，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟将本次结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动。

三、募集资金专项账户情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司依据相关规定要求管理和使用募集资金，截至

本公告披露日，公司募集资金专户情况如下：

账户名称	金融机构名称	账号	账户状态
鸿日达科技股份有限公司	招商银行股份有限公司昆山分行	512907714510508	正常
鸿日达科技股份有限公司	中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行	8112001013100684046	正常
鸿日达科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司苏州姑苏支行	636892708	正常
鸿日达科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	89070078801000002857	正常
汉江机床（昆山）有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	89070078801300002862	正常
鸿日达科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行	32250198645000001410	正常
鸿日达科技股份有限公司	昆山农村商业银行股份有限公司玉山支行	2010020114341	正常
东台润田精密科技有限公司	招商银行股份有限公司昆山高新区支行	515900861010901	正常
东台润田精密科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	89070078801400003299	正常
东台润田精密科技有限公司	中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行	8112001013300804676	本次拟注销
鸿科半导体（东台）有限公司	中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行	8112001012700922315	正常
鸿日达科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89070078801100003851	正常

公司将半导体金属散热片材料项目待支付款项支付完毕，并将节余募集资金转出完毕后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金专户，公司及相关子公司与保荐人及存放募集资金的商业银行签订的募集资金专户存储四方监管协议将相应终止。

四、本次募投项目结项的相关审核及批准程序

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，节余募集资金金额低于 500 万元人民币且低于该项目募集资金净额的 5%，可以豁免履行相关审议程序。

因此，公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事宜无需董事会审议，亦无需保荐机构发表明确同意意见，公司将在后续年度报告中披露其使用情况。

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日